

平成29年1月17日

各位

会社名 宇部エクシモ株式会社
本社所在地 東京都中央区日本橋富沢町9番19号
問合せ先 総務部長 多田 厚美
TEL 03-6667-2411

自動車向けFPC材料の量産化について

宇部エクシモ株式会社（社長：渡邊史信）は、自動車向けの基板材料として最適なフレキシブルプリント配線板（以下「FPC」）材料「ユピセル®N-厚銅タイプ」および放熱基板材料「ユピセル®H」を量産化、本格販売を開始した。

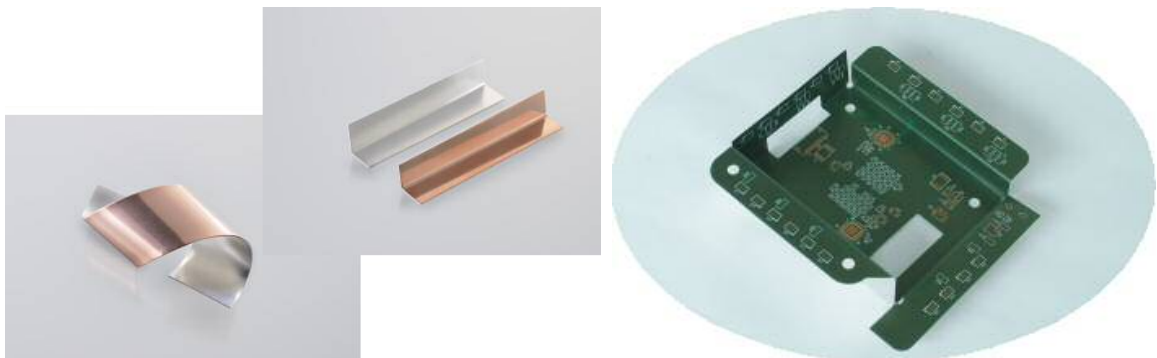
近年、自動車分野においては、ハイブリッド車や電気自動車の普及を背景に、車載用電子部品の数が増加し、なかでも回路基板は、軽量化に加え、大電流化への対応と放熱対策が課題とされている。

「ユピセル®N-厚銅タイプ」は、絶縁層にポリイミドフィルムを使用した無接着剤タイプのFPC材料で、今回量産化した厚銅タイプは、従来品よりも厚い100 μ m以上の銅箔を採用することで回路導体の断面積を増やし、従来の回路導体幅を拡大することなく大電流化への対応が可能で、また同時に放熱性の向上も期待できる。

一方の「ユピセル®H」は、絶縁層にポリイミドフィルムを使用した無接着剤タイプのFPC材料に、放熱板としてアルミをラミネートした超薄型、軽量の放熱基板材料で、ポリイミドの高い絶縁耐圧特性を利用して、絶縁層を薄くすることで高い放熱性を実現。従来の放熱基板と比較し、薄型化、軽量化を図りながら、立体加工ができることを特徴としている。

いずれの製品も、独自の高温かつ均一に圧力をかけることのできる高度なラミネート技術を用いることにより、従来困難であったアルミや100 μ mを超える厚い銅箔とのラミネートを実現した。

自動車のパワーモジュールやLEDライト向けの基板材料として採用拡大を目指す。



ユピセル®H 加工例

「ユピセル®H」、「ユピセル®N（厚銅タイプ）」は、第7回クルマの軽量化技術展（会期：2017年1月18日～20日、会場：東京ビッグサイト）に出展いたします。